

自动高压热压机 90吨 300X300Mm 压板 0.2% 压力精度 200°C

货号: XP65



简介

探索这款自动高压热压机，它在300×300毫米压板上提供90吨压力，压力精度达0.2%，并具有高达200°C的精确PID温度控制，是电池研究、半导体封装、聚合物成型和复合材料致密化的理想选择。

了解更多

应用	描述	主要优势
固态电池层压	在高压下压实电极和固体电解质层，以降低界面电阻，提高离子电导率和电池性能。多步压力曲线允许优化的层压循环，而不会损坏精细材料。	利用90吨压力实现无缺陷界面。
半导体封装	在高达200°C的受控温度下，对大尺寸基板、芯片或封装材料进行精密热压键合。均匀的压力确保了可靠、无空洞的键合，这对先进封装技术至关重要。	一致的键合完整性和平面度。
聚合物成型	在高夹持力和恒定热量下模塑和固化工程塑料、PTFE、聚乙烯和橡胶片材。可编程循环确保可重复的零件质量和尺寸精度。	高密度、尺寸精确的零件。
复合材料致密化	使用多阶段热压曲线压实纤维增强复合材料、预浸料和层压板，以消除空隙并增加纤维体积分数。	增强机械强度和耐久性。
陶瓷基板层压	压制用于LTCC/HTCC模块的多层陶瓷生坯带，确保均匀的厚度和附着力。均匀的压力分布可防止开裂和分层。	高良率生产可靠的基板。
燃料电池MEA组装	热压质子交换膜燃料电池的膜电极组件，在精确的温度和压力下将催化剂层粘合到膜上，以优化三相边界。	优化性能和耐久性。
溅射靶材键合	使用高压和热量将溅射靶材键合到背板上，确保形成坚固、导热的界面，能够承受热循环。	可靠键合，无空洞或热点。
粘合剂层压	使用受控的力和热量，在异种材料（如金属和玻璃）之间固化结构粘合剂，用于光学或航空航天部件。	牢固、光学透明的粘合，无气泡。

参数	规格	备注
型号	XP65-90T3030	高压自动热压机
最大压力	0 - 90 吨 (900 kN)	PIDS闭环液压控制，实现稳定施力
压力传感器精度	±0.2%	高精度传感器确保压力漂移最小
工作温度	0 - 200 °C (最高 200°C)	针对高达200°C的热对称性和平整度进行优化
温度控制	PID可编程控制器	7英寸彩色触摸屏界面，支持多步编程
加热功率	3500 W	高效加热，热损失低
压板尺寸	300 × 300 mm	适用于最大300×300 mm的样品
最大表面压力	~100 Bar (10 MPa)	在90吨压力下作用于整个压板区域时达到
电源	交流 220V / 50Hz (单相)	需要专用16A电路以确保安全运行
尺寸 (宽×深×高)	600 × 520 × 650 mm	紧凑的台式占地面积
重量	350 kg	重型结构确保刚性；请确保工作台承重